

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，则公司拟合计派发的现金分红总金额不变，每 10 股派发现金红利金额作相应调整，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处的半导体专用设备制造领域，对于持续研发的需求较高，资金需求量较大。本次利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 84,794,096.91 元，其中母公司实现净利润 86,436,435.62 元。根据《中华人民共和国公司法》《天津金海通半导体设备股份有限公司公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积金后截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 367,181,731.06 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户

除外)每10股派发现金红利1.77元(含税),不以公积金转增股本、不送红股。公司截至2024年4月26日的总股本60,000,000股,以扣除截至2024年4月26日公司回购专用证券账户的股份2,423,970股后的57,576,030股为基数测算,公司拟合计派发的现金分红总金额为10,190,957.31元(含税)。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司回购专用证券账户股份数量发生变动的,则公司拟合计派发的现金分红总金额不变,每10股派发现金红利金额作相应调整,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。

本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年,公司实现归属于母公司所有者的净利润84,794,096.91元,公司拟分配的现金红利总额为10,190,957.31元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一) 公司所处行业情况及特点

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。集成电路行业是技术密集、知识密集的高科技行业对测试设备技术要求较高。为保持技术的先进性和产品的竞争力集成电路测试设备需要进行持续的研发,从研发、试产、质控到市场推广和销售的各阶段,需要投入较高人力成本及研发费用等经常性开支,资金需求量较大。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

公司处于成长阶段,公司将继续专注服务半导体封装测试行业,根据国家政策和战略发展需求,不断加强自主技术创新能力,努力拓宽客户群体和市场,积极促进科技成果产业化。公司将继续加深与下游客户的合作,时刻把握市场动态,围绕自身技术优势,结合行业发展趋势,持续进行研发创新和技术升级。

(三) 公司盈利水平及资金需求

2023年,公司实现归属于母公司所有者的净利润84,794,096.91元。公司业务还在持续发展,为保障公司业务发展,公司有较高的资金需求。

(四) 公司现金分红水平较低的原因

公司坚持稳健的利润分配政策,在制定每年的分红政策时,会综合平衡当年

的利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报。本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素而做出的合理安排，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场等，确保公司长期稳健发展，为股东创造长期稳定的回报。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持提升软、硬件研发能力，完善研发体系，提高团队专业化程度，提升生产运营效率以及深化公司核心竞争力，积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红形式对投资者进行回报，为全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日